

锡浆

◆ 产品描述

高纯度锡浆，成分均匀稳定，流动性佳，焊接附着力强，适配精密电子元器件焊接，满足批量生产与手工操作需求。



◆ 产品优势

- 成分均匀
- 流动性好
- 附着力强
- 纯度达标
- 适配性广

◆ 产品结构

以高纯度锡为基材，添加专用助焊成分，经均质化处理制成膏状，密封包装防止氧化，质地细腻无颗粒

◆ 产品特性

锡含量：≥99.3%

中温熔点：138°/183°

粘度：8000-12000 CPS

工作温度：230-260℃

保质期 6 个月（冷藏）

物料编码	中温熔点	重量	包装方式
1.5.19.03.0029	138°	0.06kg	独立包装
1.5.19.03.0030	183°	0.042kg	独立包装

◆ 应用场景

- ◆ 电子元器件焊接、电路板批量生产、精密仪器组装、手工 DIY 焊接、小型电子设备维修

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有